附件1：

**2020·中国电子材料产业技术发展大会**

**会议安排**

本次大会包括：大会开幕式、大会主论坛、专业分论坛、高端圆桌会、展览展示及考察交流活动。

**（一）大会主论坛**

**时间：2020年12月4日 全天**

**地点：广州汇华希尔顿逸林酒店**

大会将邀请工信部司局领导，广东省等主管领导出席，邀请电子材料行业权威的中国中科院、中国工程院院士、各专业领域专家，及国家集成电路产业投资基金公司、中电科、华为、中芯国际、TCL等电子科技龙头企业高管等论坛上进行主旨演讲。

计划邀请院士专家：

中国工程院 干勇院士

中国工程院 屠海令院士

中国工程院 王海舟院士

清华大学 周济院士

西安电子科技大学 郝跃院士

钢铁研究总院 李卫院士

浙江大学 杨德仁院士

南昌大学 江风益院士

四川大学 李言荣院士

国家集成电路产业投资基金

中电科集团企业高管

华为海思企业高管等等

**（二）专业分论坛**

**时间：2020年12月5日**

**地点：广州科学城会议中心**

**第一分论坛：先进半导体材料**

研讨主题：大尺寸硅材料、III-V族化合物半导体材料、宽禁带半导体材料、超宽禁带半导体材料、硅基化合物半导体材料、先进半导体材料国产化应用。

**第二分论坛：集成电路先进制程用材料**

研讨主题：集成电路制程技术及关键工艺材料，光刻胶及配套、超高纯金属靶材、超纯化学品、电子特气、CMP 材料、掩膜版及石英材料等突破与创新。

**第三分论坛：5G基材及终端电子材料**

研讨主题：5G用通讯基材—高频高速 CCL与电子铜箔等电子材料，柔性CCL及PI材料、5G终端用电磁屏蔽材料、5G用磁性材料、导热散热材料等新技术新材料新应用。

**第四分论坛：5G/AI压电晶体与电子陶瓷材料**

研讨主题：Al压电晶体市场发展新趋势、滤波新一代压电材料、电子陶瓷材料、导电银浆等电子材料技术进展等。

**第五分论坛：先进封接材料技术与可靠性**

研讨主题：新型电子封接、互连与热管理材料的制备与应用，电子材料测试表征、可靠性评价、数据应用。

**第六分论坛：新型显示光电材料与技术**

研讨主题：有机发光显示材料、印刷 OLED 显示材料、量子点发光显示材料、Mini-LED/Mirco-LED 显示材料，以及相应的配套功能材料与技术及研发应用。

**第七分论坛：粤港澳大湾区电子材料产业发展论坛**

研讨议题：1.粤港澳大湾区新材料/电子材料产业发展趋势与机遇；2.广州市重点产业政策推介；3.广州市 2020年新材料首批次目录及重点产品发布；4.新材料产业发展投资基金；5.重点产业产业载体/电子材料创新项目。

**（三）电子新材料新技术展**

**时间：2020年12月4日~5日**

**地点：广州科学城会议中心**

电子新材料新技术展以构建电子材料产业资讯服务及区域企业洽商交流平台。通过“展+会”的开发模式，以及“线上+线下”的衍生型服务，为参展企业导入多元业态价值，促进与引导电子材料行业的全面升级服务。

展览作为大会配套同期举行，2天。

**（四）产业考察、供需对接等交流活动**

广州市新材料特色产业园区、开发区产业政策推荐、参观考察活动；

广州市重点电子材料企业和应用企业实地考察活动；

供需对接，新成果、产融投资对接、产业载体/创新项目推介与合作对接活动等。